斜入射X線回折法によるガスクラスターイオンビーム加工の表面損傷の評価

(株)日立製作所 平野辰巳

tatsumi.hirano.nm@hitachi.com

記録密度の高い磁気ディスク装置の開発には、ヘッド浮上面を超平坦化する高度な加工技術が必要となる。そこで、 低損傷加工と超平坦化が可能なガスクラスターイオンビーム(GCIB)に着目した。SIMS による組成分析により、加工損 傷を 3nm 以下に低減できることがわかった。しかし、SIMS では GCIB 照射が結晶構造に与える影響を評価できない。そ こで、斜入射X線回折法を用いて、GCIB 照射した PtMn 磁性膜の表面損傷を評価した。試料は Si 基板上に成膜した

PtMn(膜厚 60nm、無配向、fcc 構造)を用い、基板面法線に対する GCIB の照射角 を変数とした。斜入射X線回折法により、試料へのX 線の侵入深さを制御しながら、その薄膜回折と面内回折から歪を評価 した。

アズデポの試料 A では、膜全体で + 0.4%の圧縮歪となり、最表面 で - 0.4%の引張歪となっている。照射角 0 度の試料 B では、膜全体の 歪は + 0.1%程度(圧縮)と小さくなり、応力が緩和したことを示している。 この照射条件では損傷が大きいことがわかる。一方、照射角 80 度の 試料 C の歪分布は試料 A の分布と類似しており、GCIB 照射の低損傷 加工が実現されていることがわかった。本研究の一部は新エネルギ ー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けて行われたものであ る。

























